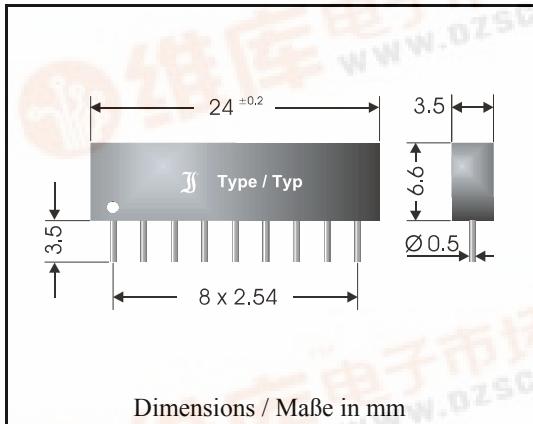


## **Small Signal Diode Arrays**

## **Dioden Sätze mit Allzweckdioden**



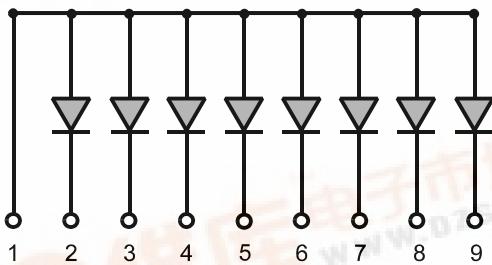
Nominal power dissipation 200 mW  
Nenn-Verlustleistung

Repetitive peak reverse voltage  
Periodische Spitzensperrspannung

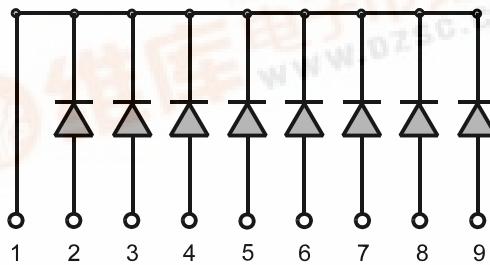
9 Pin-Plastic case                    24 x 3.5 x 6.6 [mm]  
9 Pin-Kunststoffgehäuse

Weight approx. – Gewicht ca. 0.6 g

Standard packaging: bulk see page 22  
Standard Lieferform: lose im Karton s. Seite 22



"DAP": common anodes / gemeinsame Anoden  
"DA4148A": common anodes / gemeinsame Anoden



"DAN": common cathodes / gemeinsame Kathoden  
"DA4148K" : common cathodes / gemeinsame Kathoden

## Maximum ratings

# Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
DAN 803 = DA 4148 K	80	80
DAP 803 = DA 4148 A	80	80

Max. average forward rectified current, R-load,  
for one diode operation only  
per diode for simultaneous operation

$$T_A = 25^\circ\text{C}$$

$$\begin{array}{ll} I_{FAV} & 100 \text{ mA}^{-1}) \\ I_{FAV} & 25 \text{ mA}^{-1}) \end{array}$$

Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last,  
für eine einzelne Diode  
pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb

$$T_U = 25^\circ\text{C}$$

I<sub>FAV</sub> 100 mA<sup>1)</sup>  
I<sub>FAV</sub> 25 mA<sup>1)</sup>

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave  
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle

$T_A = 25^\circ\text{C}$

I<sub>ESM</sub> 500 mA

<sup>1)</sup> Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur  
 Storage temperature – Lagerungstemperatur

$T_j$  – 50...+150°C  
 $T_s$  – 50...+150°C

### Characteristics

### Kennwerte

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 10 \text{ mA}$	$V_F$	< 1.0 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 20 \text{ V}$	$I_R$	< 25 nA
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10 \text{ mA}$ through/über $I_R = 10 \text{ mA}$ to/auf $I_R = 1 \text{ mA}$		$t_{rr}$	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft			$R_{thA}$	< 85 K/W <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
 Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten